

BGA植球机自动植球设备芯片植球机厂家

产品名称	BGA植球机自动植球设备芯片植球机厂家
公司名称	深圳市德正智能科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:德正智能 型号:DEZ-ZQ1800 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道江边第二工业区19栋
联系电话	0755-27218816 13670102286

产品详情

BGA植球机自动植球设备芯片植球机厂家

BGA芯片植球机产品特点：

一、用途

本型号适用于高精密度芯片或主板类植球,晶圆植球等，可适用于高重复定位型植球加工行业。具体应用范围

(1)支持 BGA, QFN封装等，小球径(Ball) 0.2mm;大球径1.27mmBGA植球机

(2)各种PCBA主板，要求精密的电路主板上锡，小主板，小尺寸2*2MM，大适用220*110的物件的印刷

二、产品规格及技术参数

植球机台采用进口双导轨进行重复移位作业，高精密电动升降平台机构，确保每一次定位位移重叠且准确（误差度0.01mm）

控制模具与钢网的分离，速度及行程可以灵活实现多种脱模方式。快速锁紧式钢网螺杆，方便于更换不同规格钢网。BGA植球机

BGA植球机整机技术参数：

重复定位精度：±12 μ M

印刷精度：±15 μ M

循环时间：< 30S(不包括芯片装模板时间)

本机采用定位柱方式进行快速对位，并可

通讯接口：USB2.0

进料速度：人工

脱模速度：0.1~15MM/sec

植球速度：3000 PCS/H(与模板的设计有关)

BGA植球机电源：AC220 ± 10% ， 50/60HZ 100W

压缩空气：配真空泵或真空发生器

工作环境温度：-20 ~+45

工作环境湿度：30~60%

机器重量：30KG

设备尺寸：长：580mm，宽：610mm，高：430 mm(定制型的以实物为准)

操作系统：HMI+PLC

三、使用的工具钢网模板规格

基座尺寸：240*160mm (其它尺寸可按要求定制大可以400*400)

基座厚度：30mm

模板尺寸：120*160mm (其它尺寸可按要求定制大可以380*380)

模板厚度：3-5mm (根据客户要求定做)

基座大重量：5KG

钢网尺寸范围：280*420mm (其它规格可定制MAX420*420MM)

钢网厚度：0.08~0.3mm

芯片或模板固定：定位框及真空吸附